

臻宝科技 (688797.SH)

新股覆盖研究

投资要点

- ◆ 6月9日有一家科创板上市公司“臻宝科技”询价。
- ◆ 臻宝科技 (688797)：公司专注于为集成电路及显示面板行业客户提供制造设备真空腔体内参与工艺反应的零部件及其表面处理解决方案。公司 2023-2025 年分别实现营业收入 5.06 亿元 /6.35 亿元 /8.68 亿元，YOY 依次为 31.31%/25.31%/36.73%；归母净利润 1.09 亿元/1.52 亿元/2.26 亿元，YOY 依次为 34.03%/38.82%/48.78%。根据公司初步预测，2026H1 营业收入较 2025 年同期增长 28.83%至 34.29%，归母净利润较 2025 年同期增长 23.26%至 35.00%。
- ② **投资亮点：1、人工智能驱动下，刻蚀、薄膜沉积等工艺设备及其配套部件迎来需求增长与技术升级机遇。**人工智能产业的较快发展持续拉动先进制程芯片、存储芯片需求增长，而随着芯片制程工艺的迭代和堆叠层数的增加，也大幅提升了对刻蚀、薄膜沉积设备使用频次和性能的要求，进一步加速配套零部件的需求扩容与迭代升级。以刻蚀设备为例，20nm 工艺需要的刻蚀步骤约为 50 次，而 10nm 和 7nm 工艺所需刻蚀步骤超过 100 次；同时，随着存储芯片堆叠层数从 1XX 层向 2XX/3XX 层以上演进，高深宽比刻蚀工艺的应用频次显著增加，更高堆叠层数的制造工艺亦要求更高的刻蚀速率、刻蚀精度和刻蚀稳定性。**2、公司是我国半导体设备零部件核心供应商，依托“原材料+零部件+表面处理”的一体化业务优势，目前在硅、石英零部件细分市场占据龙头地位。**公司自 2016 年成立以来，始终专注于半导体及显示面板设备的核心零部件领域。在收入占比超七成的半导体设备零部件方面，公司持续深耕集成电路等离子体刻蚀、薄膜沉积等关键环节半导体设备零部件；依托于大直径单晶硅棒、化学气相沉积高纯碳化硅材料、陶瓷造粒粉体等关键半导体材料技术突破和曲面硅上部电极、石英气体分配盘、超纯碳化硅环等核心零部件产品品类拓展，以及熔射再生、阳极氧化等表面处理服务技术攻坚，成为国内少数具有“原材料+零部件+表面处理”一体化业务优势的企业，助力我国实现等离子体刻蚀和薄膜沉积设备关键零部件的自主可控。目前，公司半导体设备零部件产品已批量应用于逻辑类 14nm 及以下技术节点先进工艺集成电路制造、存储类 200 层及以上堆叠先进工艺 3D NAND 闪存芯片制造、20nm 及以下技术节点 DRAM 先进工艺存储芯片制造等领域，与多家国内前十大集成电路制造企业建立了稳定的业务合作关系，并成功拓展了英特尔（大连）、格罗方德、联华电子和德州仪器等海外客户。同时，国家大基金二期为公司第六大股东，中芯国际、长江存储、华虹半导体等行业龙头亦通过旗下平台入股，为公司带来较强产业支撑。根据弗若斯特沙利文数据，2024 年直接供应晶圆厂的半导体设备零部件本土企业中，公司以 4.5%和 8.8%的市占率分别在硅零部件、石英零部件市场排名第一。此外，据招股书披露，公司还将重点拓展石墨、高致密涂层等材料以及半导体静电卡盘、碳化硅气体分配盘、氮化铝加热器等新型零部件，进一步提升公司长期竞争力。
- ② **同行业上市公司对比：**公司聚焦集成电路及显示面板领域非金属零部件的研发产销；根据主营业务的相似性，选取先锋精科、珂玛科技、富乐德、富创精密、凯德石英为臻宝科技的同行可比公司。从上述可比公司来看，2025 年可

交易数据

| | |
|------------|--------|
| 总市值 (百万元) | |
| 流通市值 (百万元) | |
| 总股本 (百万股) | 116.47 |
| 流通股本 (百万股) | |
| 12 个月价格区间 | / |

分析师

李蕙
 SAC 执业证书编号：S0910519100001
 lihui1@huajinsec.cn

分析师

戴尊等
 SAC 执业证书编号：S0910526030001
 daizhengzheng@huajinsec.cn

相关报告

- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告（惠科股份）-2026 年 66 期-总第 703 期 2026.6.9
- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告（永大股份）-2026 年 65 期-总第 702 期 2026.6.8
- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告（金戈新材）-2026 年 64 期-总第 701 期 2026.6.4
- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告（彩客科技）-2026 年 63 期-总第 700 期 2026.6.3
- 华金证券-新股-新股专题覆盖报告（高特电子）-2026 年 61 期-总第 698 期 2026.5.28



比上市公司的平均收入规模为 18.00 亿元，平均 PE-TTM（剔除异常值/算术平均）为 121.82 倍，平均销售毛利率为 34.72%；相较而言，公司营收规模未及可比公司平均，但销售毛利率处于同业的中高位区间。

- ◆ **风险提示：**已经开启询价流程的公司依旧存在因特殊原因无法上市的可能、公司内容主要基于招股书和其他公开资料内容、同行业上市公司选取存在不够准确的风险、内容数据截选可能存在解读偏差等。具体上市公司风险在正文内容中展示。

公司近 3 年收入和利润情况

| 会计年度 | 2023A | 2024A | 2025A |
|------------|-------|-------|-------|
| 主营收入(百万元) | 506.4 | 634.5 | 867.6 |
| 同比增长(%) | 31.31 | 25.31 | 36.73 |
| 营业利润(百万元) | 127.5 | 171.6 | 264.9 |
| 同比增长(%) | 35.09 | 34.53 | 54.39 |
| 归母净利润(百万元) | 109.4 | 151.9 | 225.9 |
| 同比增长(%) | 34.14 | 38.82 | 48.78 |
| 每股收益(元) | 1.07 | 1.30 | 1.94 |

数据来源：聚源、华金证券研究所

内容目录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、臻宝科技 | 4 |
| (一) 基本财务状况 | 4 |
| (二) 行业情况 | 5 |
| (三) 公司亮点 | 11 |
| (四) 募投项目投入 | 12 |
| (五) 同行业上市公司指标对比 | 12 |
| (六) 风险提示 | 13 |

图表目录

| | |
|---|----|
| 图 1: 公司收入规模及增速变化 | 5 |
| 图 2: 公司归母净利润及增速变化 | 5 |
| 图 3: 公司销售毛利率及净利润率变化 | 5 |
| 图 4: 公司 ROE 变化 | 5 |
| 图 5: 中国晶圆厂非金属零部件采购额 (按供应商类型拆分) | 6 |
| 图 6: 中国晶圆厂石英零部件采购额 (按供应商类型拆分) | 7 |
| 图 7: 中国晶圆厂陶瓷零部件采购额 (按供应商类型拆分) | 7 |
| 图 8: 中国晶圆厂硅零部件采购额 (按供应商类型拆分) | 8 |
| 图 9: 中国显示面板厂商零部件采购额 (按供应商种类拆分) | 9 |
| 图 10: 中国显示面板厂商非金属零部件采购额 (按供应商种类拆分) | 9 |
| 图 11: 中国显示面板厂商陶瓷零部件采购额 (按供应商类型拆分) | 9 |
| 图 12: 中国半导体设备零部件表面处理服务市场规模 (按服务类型拆分) | 10 |
| 图 13: 中国显示面板设备零部件表面处理服务市场规模 (按服务类型拆分) | 11 |
| 表 1: 公司 IPO 募投项目概况 | 12 |
| 表 2: 同行业上市公司指标对比 | 13 |

一、臻宝科技

公司专注于为集成电路及显示面板行业客户提供制造设备真空腔体内参与工艺反应的零部件及其表面处理解决方案，核心产品包括硅、石英、碳化硅和氧化铝陶瓷等设备零部件产品，以及熔射再生、阳极氧化和精密清洗等表面处理服务，主要应用于集成电路行业等离子体刻蚀、薄膜沉积等工艺的半导体设备和显示面板行业等离子体刻蚀、薄膜沉积和蒸镀等工艺的面板制造设备。

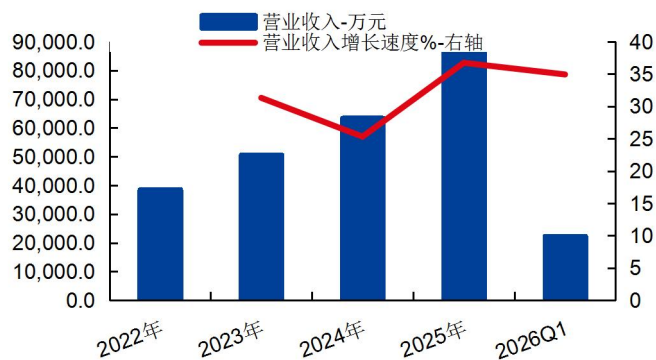
公司具备坚实的研发能力，在硅、碳化硅等半导体材料的制备环节，形成了大直径单晶硅棒控制和碳化硅气相沉积等关键材料制备技术；在硅、石英、陶瓷和碳化硅等硬脆半导体材料的高精密加工环节，形成了微深孔精密制造、曲面精加工和微深孔刻蚀等精密加工技术；在精密清洗、阳极氧化和熔射再生等表面处理环节，阶段性突破了高致密涂层制备等表面处理技术，形成了“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台。公司还自主开发了加工刻蚀液、加工工具和装置，是国内少数实现集成电路先进制程设备和高世代、高电压显示面板制造设备非金属零部件多品类供应、规模化量产的企业之一。此外，公司还积极牵头承担国家发改委重大技术装备攻关专项项目，协助行业龙头客户推进重点攻关项目国产化研发，助力国产供应链体系的完善和自主可控，保障集成电路制造行业的稳定可持续发展。

（一）基本财务状况

公司 2023-2025 年分别实现营业收入 5.06 亿元/6.35 亿元/8.68 亿元，YOY 依次为 31.31%/25.31%/36.73%；归母净利润 1.09 亿元/1.52 亿元/2.26 亿元，YOY 依次为 34.03%/38.82%/48.78%。根据最新财报情况，2026Q1，公司实现营业收入 2.23 亿元，同比增长 34.93%；实现归属于母公司净利润 0.51 亿元，同比增长 72.38%。

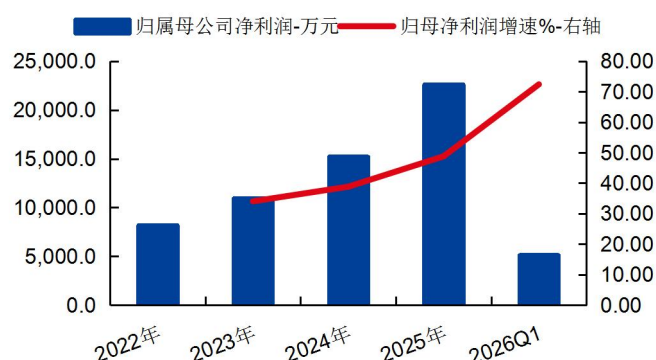
2025 年，公司主营业务收入按应用场景可分为三大板块，分别为半导体行业（6.56 亿元，占 2025 年主营收入的 77.54%），显示面板行业（1.89 亿元，占 2025 年主营收入的 22.37%），其他行业（75.19 万元，占 2025 年主营收入的 0.09%）。2023-2025 年，半导体行业始终为公司主要收入来源，其收入占比稳定在 60%以上，且呈逐年增长态势。

图 1：公司收入规模及增速变化



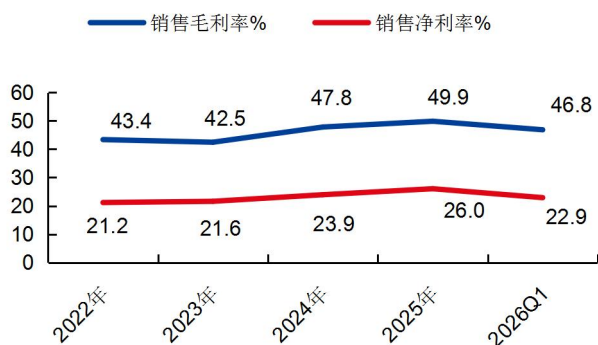
资料来源：iFind，华金证券研究所

图 2：公司归母净利润及增速变化



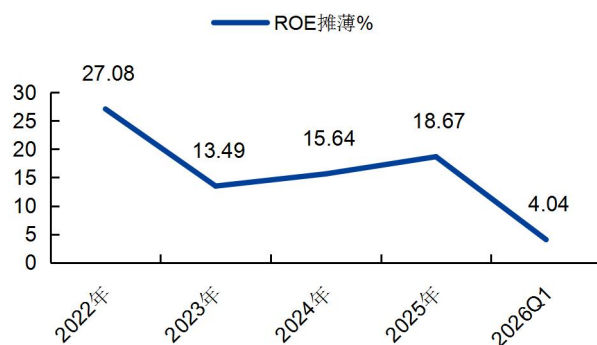
资料来源：iFind，华金证券研究所

图 3：公司销售毛利率及净利率变化



资料来源：iFind，华金证券研究所

图 4：公司 ROE 变化



资料来源：iFind，华金证券研究所

（二）行业情况

公司零部件产品主要应用于半导体行业及显示面板行业。

1、半导体行业

公司主要聚焦于芯片制造环节，主要为晶圆厂供应刻蚀、薄膜沉积设备零部件产品及表面处理服务，位于半导体产业链中游。

全球半导体设备行业随下游终端产品景气度每隔 3-4 年会呈周期性变动趋势。当下游终端产品技术迭代更新，激增的需求将带动资本向上游晶圆厂涌入，推动全球晶圆厂持续扩产。与此同时，随着技术节点的不断缩小，半导体设备投资呈大幅上升的趋势，成为半导体设备销售额增长的主要驱动力之一。根据 SEMI 数据，2024 年全球半导体设备出货金额达到 1,171 亿美元，相较于 2023 年的 1,063 亿美元增长 10%。而作为全球最大的半导体市场，中国大陆半导体设备销售额增速远高于全球市场；2024 年中国大陆半导体设备销售额为 495 亿美元，占全球半导体设备销售的 42.3%，同比增长 35%。2024 年全球市场前道工艺（晶圆制造）设备销售额预计为 1,042

亿美元，销售占比超过 80%，其中前道工艺设备中光刻设备、刻蚀设备和薄膜沉积设备占比最大。

从细分领域市场规模来看，1) 刻蚀设备行业方面，据 Mordor Intelligence 数据统计，2024 年全球半导体刻蚀设备市场规模预计为 238 亿美元，预计到 2029 年增长至 343.2 亿美元，年复合增长率为 7.60%，刻蚀设备零部件产品的市场规模也随之受益；目前 LAM、TEL 和 AMAT 三家占全球干法刻蚀设备的份额占比较高，行业集中度高。2) 薄膜沉积设备行业方面，根据 Maximize Market Research 数据，全球薄膜沉积设备整体规模稳定增长，2023 年市场规模为 260 亿美元，预计至 2029 年市场规模可达 559 亿美元。在全球 CVD 设备市场中，AMAT、LAM、TEL 和 ASMI 四大厂商占据了市场主要份额，行业集中度高。

根据弗若斯特沙利文数据，2024 年，在国内晶圆厂的半导体设备零部件整体 177.2 亿元的采购额中，向零部件厂商直接采购的占比达到了 71.4%，采购额达到 126.6 亿元。未来，随着国内晶圆厂加大对零部件厂商的采购力度，预计向零部件厂商直接采购的比例将逐步上升。预计到 2029 年，国内晶圆厂向零部件厂商直接采购的占比将达到 80.3%，采购额将达到 291.8 亿元。

在半导体设备零部件当中，因损耗较多，与金属零部件相比，半导体设备的非金属零部件采购以消耗型零部件为主，晶圆厂向零部件厂商直接采购非金属零部件的占比也更高。根据弗若斯特沙利文数据，2024 年，在国内晶圆厂的非金属零部件整体 113.5 亿元的采购额中，向零部件厂商直接采购的占比达到了 70.8%，采购额达到 80.4 亿元。未来，随着晶圆厂加大对关键零部件供应链的自主把控力度，以及对本土供应商的积极扶持，预计向零部件厂商直接采购的比例将逐步提高。预计到 2029 年，在国内晶圆厂的非金属零部件整体 262.7 亿元的采购额中，向零部件厂商直接采购的占比将达到 80.7%，采购额达到 212.0 亿元。

图 5：中国晶圆厂非金属零部件采购额（按供应商类型拆分）



资料来源：弗若斯特沙利文，华金证券研究所

①石英零部件市场规模：根据弗若斯特沙利文数据，2024 年，在晶圆厂 34.8 亿元的石英零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 22.7 亿元，占比 65.3%，预计在 2029 年可达 56.5 亿元，占比 75.9%。

图 6：中国晶圆厂石英零部件采购额（按供应商类型拆分）



资料来源：弗若斯特沙利文，华金证券研究所

②陶瓷零部件市场规模：根据弗若斯特沙利文数据，2024 年，在晶圆厂 29.4 亿元的陶瓷零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 19.3 亿元，占比 65.6%，预计 2029 年可达 52.5 亿元，占比 75.3%。

图 7：中国晶圆厂陶瓷零部件采购额（按供应商类型拆分）



资料来源：弗若斯特沙利文，华金证券研究所

③硅零部件市场规模：根据弗若斯特沙利文数据，2024 年，在晶圆厂 43.8 亿元的硅零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 35.7 亿元，占比 81.6%，预计 2029 年可达 96.9 亿元，占比 89.22%。

图 8：中国晶圆厂硅零部件采购额（按供应商类型拆分）



资料来源：弗若斯特沙利文，华金证券研究所

2、显示面板行业

公司主要聚焦于显示面板制造环节，为薄膜沉积、刻蚀和蒸镀设备提供零部件产品及表面处理服务，属于显示面板产业链中游。

显示面板主要分为液晶（LCD）显示面板和有机发光二极管（OLED）显示面板两大类。其中，LCD 由于其技术的成熟性，以及在大屏幕显示如电视、笔记本电脑等的广泛应用，总需求和市场份额占比较大。OLED 因其独特的柔性特质，能满足曲面和折叠屏的需求，被广泛应用于手机等小屏幕显示领域，同时也应用于一些新兴的电子产品如 VR、可穿戴设备等，需求增速更快。

LCD 与 OLED 生产工艺均可分为前段 Array、中段 Cell 与后段 Module 三部分。在前段 Array 制程中，LCD 和 OLED 工艺和设备大致相同，与半导体类似，都需要刻蚀设备和薄膜沉积设备。在中段 Cell 制程中，LCD 与 OLED 的制程差异较大，OLED 需要蒸镀设备。在后段 Module 制程中，LCD 与 OLED 的工艺设备大致相同，主要设备有绑定、贴合、点胶和检测等设备。

公司显示面板设备零部件产品以定制化产品为主，需与显示面板设备适配，属于加工类零部件。从需求端角度，根据弗若斯特沙利文数据，2023 年，在显示面板厂商 56.2 亿元的零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 47.8 亿元，占比 85.1%，预计 2028 年可达 81.3 亿元，占比 90.3%。同时，2023 年在显示面板厂商 16.4 亿元的非金属零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 14.1 亿元，占比 86.0%，预计 2028 年可达 24.2 亿元，占比 90.6%。

图 9：中国显示面板厂商零部件采购额（按供应商种类拆分）



资料来源：弗若斯特沙利文，华金证券研究所

图 10：中国显示面板厂商非金属零部件采购额（按供应商种类拆分）



资料来源：弗若斯特沙利文，华金证券研究所

①石英零部件市场规模：根据弗若斯特沙利文数据，2024 年，在晶圆厂 34.8 亿元的石英零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 22.7 亿元，占比 65.3%，预计在 2029 年可达 56.5 亿元，占比 75.9%。

图 11：中国显示面板厂商陶瓷零部件采购额（按供应商类型拆分）



资料来源：弗若斯特沙利文，华金证券研究所

3、半导体和显示面板设备零部件表面处理行业

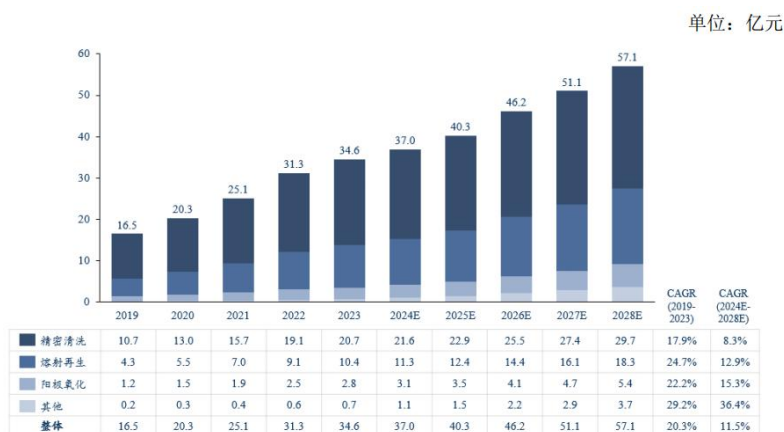
表面处理既是硅、石英、陶瓷和金属等材质零部件制造的主要工序之一，也可用于旧零部件的更新，如精密清洗可以清除其表面的污染附着物，阳极氧化和熔射再生可以改善或克服母材弱点，提高零部件的耐腐蚀性，延长使用寿命。根据弗若斯特沙利文数据，针对新品制造的表面处理服务市场规模相对较小（仅考虑由设备厂商委托专业第三方表面处理服务厂商的部分，不包括设备厂商自行实施的部分），仅约占整体市场规模的 5%；对旧零部件的表面处理约占整体市场规模的 95%，是行业主要需求来源。

半导体及显示面板设备反应腔内零部件由于长期处于真空、高温、高电压的特殊环境，需通过表面处理工艺，实现零部件在特殊环境下的耐腐蚀、耐击穿电压、耐高温、平整度、洁净度和粗糙度等性能，因此表面处理是设备零部件生产以及再生的核心工序，直接影响设备零部件的核心性能，对设备和工艺稳定性、质量和良率有重要影响。表面处理主要包括精密清洗、阳极氧化和熔射再生等工序。

(1) 半导体设备表面处理服务市场规模

随着中国半导体行业的不断发展，中国晶圆厂产能迅速扩大，也相应带动了相关表面处理服务市场的发展。根据弗若斯特沙利文数据，按表面处理服务提供商收入角度统计，中国半导体设备零部件表面处理服务市场规模从2019年的16.5亿元上升至2023年的34.6亿元，期间的年复合增长率达到20.3%，预计2028年市场规模将达到57.1亿元。按表面处理服务类型统计，精密清洗服务所占比例最高，其次是熔射再生和阳极氧化；2023年精密清洗、熔射再生及阳极氧化服务占比分别为59.8%、30.1%和8.1%，预计2024-2028年，精密清洗、熔射再生和阳极氧化服务的复合增长率分别为8.3%、12.9%和15.3%。

图 12：中国半导体设备零部件表面处理服务市场规模（按服务类型拆分）

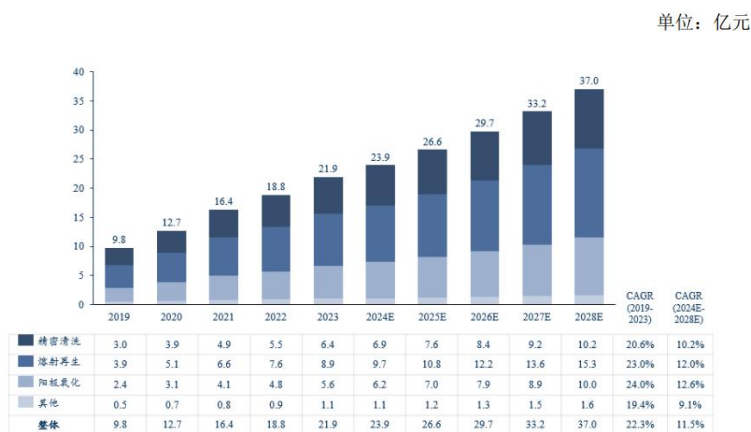


资料来源：弗若斯特沙利文，华金证券研究所

(2) 显示面板设备表面处理服务市场规模

随着我国显示面板产能规模不断增长，显示面板设备及零部件市场需求不断增加，零部件相关的表面处理服务市场也快速发展。根据弗若斯特沙利文数据，按表面处理服务提供商收入角度统计，显示面板相关的表面处理服务市场规模由2019年的9.8亿元增长至2023年的21.9亿元，期间年复合增长率为22.3%，2028年市场规模将达到37.0亿元。按表面处理服务类型统计，熔射再生所占比例最高，其次是精密清洗和阳极氧化；2023年熔射再生、精密清洗及阳极氧化服务占比分别为40.6%、29.2%和25.6%，预计2024-2028年，熔射再生、精密清洗及阳极氧化服务的复合增长率分别为12.0%、10.2%和12.6%。

图 13：中国显示面板设备零部件表面处理服务市场规模（按服务类型拆分）



资料来源：弗若斯特沙利文，华金证券研究所

（三）公司亮点

1、人工智能驱动下，刻蚀、薄膜沉积等工艺设备及其配套部件迎来需求增长与技术升级机遇。人工智能产业的较快发展持续拉动先进制程芯片、存储芯片需求增长，而随着芯片制程工艺的迭代和堆叠层数的增加，也大幅提升了对刻蚀、薄膜沉积设备使用频次和性能的要求，进一步加速配套零部件的需求扩容与迭代升级。以刻蚀设备为例，20nm 工艺需要的刻蚀步骤约为 50 次，而 10nm 和 7nm 工艺所需刻蚀步骤超过 100 次；同时，随着存储芯片堆叠层数从 1XX 层向 2XX/3XX 层以上演进，高深宽比刻蚀工艺的应用频次显著增加，更高堆叠层数的制造工艺亦要求更高的刻蚀速率、刻蚀精度和刻蚀稳定性。

2、公司是我国半导体设备零部件核心供应商，依托“原材料+零部件+表面处理”的一体化业务优势，目前在硅、石英零部件细分市场占据龙头地位。公司自 2016 年成立以来，始终专注于半导体及显示面板设备的核心零部件领域。在收入占比超七成的半导体设备零部件方面，公司持续深耕集成电路等离子体刻蚀、薄膜沉积等关键环节半导体设备零部件；依托于大直径单晶硅棒、化学气相沉积高纯碳化硅材料、陶瓷造粒粉体等关键半导体材料技术突破和曲面硅上部电极、石英气体分配盘、超纯碳化硅环等核心零部件产品品类拓展，以及熔射再生、阳极氧化等表面处理服务技术攻坚，成为国内少数具有“原材料+零部件+表面处理”一体化业务优势的企业，助力我国实现等离子体刻蚀和薄膜沉积设备关键零部件的自主可控。目前，公司半导体设备零部件产品已批量应用于逻辑类 14nm 及以下技术节点先进工艺集成电路制造、存储类 200 层及以上堆叠先进工艺 3D NAND 闪存芯片制造、20nm 及以下技术节点 DRAM 先进工艺存储芯片制造等领域，与多家国内前十大集成电路制造企业建立了稳定的业务合作关系，并成功拓展了英特尔（大连）、格罗方德、联华电子和德州仪器等海外客户。同时，国家大基金二期为公司第六大股东，中芯国际（旗下投资机构中芯聚源参与设立的聚源振芯）、长江存储（旗下投资平台长存资本发起设立的长存基金）、华虹半导体（旗下投资机构华虹虹芯）等行业龙头亦通过旗下平台入股，为公司带来较强产业支撑。根据弗若斯特沙利文数据，2024 年直接供应晶圆厂的半导体设备零部件本土企业中，公司以 4.5% 和 8.8% 的市占率分别在硅零部件、石英零部件市场排名第一。此外，据

招股书披露，公司还将重点拓展石墨、高致密涂层等材料以及半导体静电卡盘、碳化硅气体分配盘、氮化铝加热器等新型零部件，进一步提升公司长期竞争力。

（四）募投资项目投入

公司本轮 IPO 募投资金拟投入 3 个项目。

1、半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目：项目拟通过新增场地的方式，引进高端生产加工设备，构建先进生产线，对公司现有产品进行扩产；同时将继续布局上游单晶硅棒、碳化硅材料和陶瓷造粒粉等原材料产业。

2、臻宝科技研发中心建设项目：公司将基于对终端应用市场发展的深刻理解，进行静电卡盘 ESC 的研发；同时将在公司已有硅、石英和陶瓷材料体系外，新增石墨材料、炉管 SIC 材料和特殊涂层材料的自主开发，进一步丰富公司材料类产品。

3、上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目：公司将基于多年来积累的加工技术优势，以及丰富的技术研发经验，开展 ESC 静电卡盘、TCP Windows 特殊涂层、金属气体分配盘和加热盘等产品的研发。

表 1：公司 IPO 募投资项目概况

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 (万元) | 拟募集资金投资额 (万元) | 项目投资期 |
|----|------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1 | 半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目 | 81,061.32 | 75,185.06 | 4 年 |
| 2 | 臻宝科技研发中心建设项目 | 30,274.42 | 28,166.56 | 3 年 |
| 3 | 上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目 | 17,000.68 | 16,400.68 | 3 年 |
| | 总计 | 128,336.42 | 119,752.30 | - |

资料来源：公司招股书，华金证券研究所

（五）同行业上市公司指标对比

2025 年度，公司实现营业收入 8.68 亿元，同比增长 36.73%；实现归属于母公司净利润 2.26 亿元，同比增长 48.78%。根据管理层初步预测，公司预计 2026H1 实现营业收入 4.72 亿元至 4.92 亿元，较 2025 年同期增长 28.83%至 34.29%；预计实现归母净利润 1.05 亿元至 1.15 亿元，较 2025 年同期增长 23.26%至 35.00%；预计实现扣非归母净利润 0.98 亿元至 1.08 亿元，较 2025 年同期增长 14.71%至 26.41%。

公司聚焦集成电路及显示面板领域非金属零部件的研产销；根据主营业务的相似性，选取先锋精科、珂玛科技、富乐德、富创精密、凯德石英为臻宝科技的同行可比公司。从上述可比公司来看，2025 年可比上市公司的平均收入规模为 18.00 亿元，平均 PE-TTM（剔除异常值/算平均）为 121.82 倍，平均销售毛利率为 34.72%；相较而言，公司营收规模未及可比公司平均，但销售毛利率处于同业的中高位区间。

表 2：同行业上市公司指标对比

| 代码 | 简称 | 总市值 (亿元) | PE-TTM | 2025 年营业收入 (亿元) | 2025 年 营收增速 | 2025 年归 母净利润 (亿元) | 2025 年归 母净利润 增速 | 2025 年 销售毛利 率 | 2025 年 ROE (摊 薄) |
|------------------|-------------|-------------|--------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 688605.SH | 先锋精科 | 157.53 | 91.76 | 12.38 | 8.98% | 1.89 | -11.71% | 29.02% | 12.09% |
| 301611.SZ | 珂玛科技 | 492.68 | 198.76 | 10.73 | 25.19% | 2.89 | -7.04% | 51.55% | 17.54% |
| 301297.SZ | 富乐德 | 324.81 | 74.94 | 28.67 | 7.46% | 4.03 | 58.54% | 28.36% | 11.72% |
| 688409.SH | 富创精密 | 503.99 | 704.98 | 35.43 | 16.58% | -0.09 | -104.25% | 22.23% | -0.19% |
| 920179.BJ | 凯德石英 | 52.03 | 273.71 | 2.80 | -8.46% | 0.24 | -26.62% | 42.46% | 3.26% |
| | 平均值 | 306.21 | 121.82 | 18.00 | 9.95% | 1.79 | -18.21% | 34.72% | 8.88% |
| 688797.SH | 臻宝科技 | | | 8.68 | 36.73% | 2.26 | 48.78% | 49.85% | 20.72% |

资料来源：iFind（数据截至日期：2026 年 6 月 9 日），华金证券研究所

备注：PE-TTM 计算剔除 2025 年转盈为亏的富创精密、以及北交所上市的凯德石英。

（六）风险提示

客户集中度较高的风险、新产品开发及客户验证不及预期的风险、无法跟随技术升级迭代的风险、产品与服务质量风险、验收时间不可控的风险、部分原材料采购自境外的风险、半导体行业被美国等发达国家进一步制裁的风险、产业政策变化风险、经营规模扩大带来的管理风险、实际控制人及其一致行动人不当控制的风险、主要原材料价格波动风险、应收账款回收的风险、毛利率波动风险等。

投资评级说明

公司投资评级：

买入—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%；

增持—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%至 15%之间；

中性—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%至 5%之间；

减持—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数跌幅在 5%至 15%之间；

卖出—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数跌幅大于 15%。

行业投资评级：

领先大市—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数领先 10%以上；

同步大市—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨跌幅介于-10%至 10%；

落后大市—未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数落后 10%以上。

基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普 500 指数为基准。

分析师声明

李蕙、戴箬箬声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

免责声明：

本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券股份有限公司

办公地址：

上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 30 层

北京市朝阳区建国路 108 号横琴人寿大厦 17 层

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼 05 单元

电话：021-20655588

网址：www.huajinsec.com